

2008-2009年中国芯片设计 行业研究咨询报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2008-2009年中国芯片设计行业研究咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/200812/9238.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

与无可争议的全球电子制造业霸主地位相比，无“芯”之痛一直是我国电子行业最大的心病。在整个国内经济呼唤产业结构升级的背景下，位于电子行业食物链顶端的半导体业被寄予厚望，甚至被提高到了国家战略的高度。而处于半导体产业链顶端的，正是芯片设计业。毋庸置疑，国内芯片设计业近年来已经取得了长足的进步，高达60%的年复合增长率令人侧目，销售收入由2002年的21.6亿元增加到2007年的225.7亿元，并且在多媒体应用处理器、数字电视以及通信芯片等高端产品上取得突破。不过和辉煌的整体发展相比，微观层面的现象却大相径庭。据统计，目前国内芯片设计公司数目已达500家，这个数字超过了全球其他国家芯片设计公司的总和，而所有这些公司的年营业额总和尚不及美国高通公司一年的营业额，几乎就是中国民族汽车业窘况的翻版。

以前是因为国内没有IC产品，所以不得不依靠进口。现在国内IC产品越来越稳定，而且也更适合国内整机产品的要求，所以我们选择了国内产品。与国外同类产品相比，国内芯片产品有以下几方面优势：渠道更加正规；沟通便捷顺畅；交易更加简便；本土化更明显，更适合国内市场需求。和家电产业一样，国产芯片质量也会越来越高，国内芯片公司也会越来越强大。面对激烈的国际竞争，在产品创新等方面，国内企业首先应该根据自身特点和优势，找准市场定位，扬长避短开发适合自己发展的产品。其次，应该具有长远准确的市场战略眼光，制定合适的中长期的战略规划，防止总是被别人牵着鼻子走。第三，还应该具备专心致志的精神，在自己擅长的领域做强做精，而不是三心二意开拓其他领域。在知识产权方面，国内芯片公司应该勇敢地利用法律维护自己的正当权益。随着时间的推移，国内企业自主研发创新能力会越来越强，自主专利也会越来越多，国外公司知识产权包围的局面会逐步被打破。

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、工业和信息化部、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、计算机行业协会、中国电子元件行业协会、中国半导体行业协会、国内外相关刊物的基础信息以及各产业研究单位等公布和提供的大量资料。本报告对我国芯片设计行业发展现状、发展趋势、竞争格局、投资前景等进行了分析，重点对芯片设计营销策略和营销渠道等方面进行了深入探讨，是芯片设计企业、研究单位、销售企业以及相关企业和单位、计划投资于芯片设计行业的企业等准确了解目前中国芯片设计市场发展动态，把握行业发展趋势，制定市场策略的必备的精品。

目录

CONTENTS

第一部分 行业发展概述

第一章 芯片设计行业发展综述

第一节 行业界定

一、行业经济特性

二、细分市场概述

三、产业链结构分析

第二节 芯片设计行业发展成熟度分析

一、芯片设计行业发展周期分析

二、中外芯片设计市场成熟度对比

三、细分行业成熟度分析

第二章 芯片设计行业发展环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2008年国内生产总值

二、2008年工业发展形势

三、2008年固定资产投资

第二节 政策法规环境分析

一、2008年进口政策分析

二、政府优先发展IC设计业政策

三、各地IC设计产业优惠政策

四、数字电视战略推进表

五、行业标准

第三节 技术发展环境分析

一、芯片设计流程

二、低功率芯片技术可能影响整个芯片设计流程

三、我国技术创新与知识产权

四、2008年我国芯片设计技术进展

第二部分 行业发展现状

第三章 全球芯片设计行业发展现状

第一节 全球芯片设计行业发展现状

一、全球芯片设计行业产业规模

二、全球芯片设计行业产业结构

第二节 全球芯片设计行业基本特点

一、市场繁荣带动产业加速发展

二、企业重组呈现强强联合趋势

第三节 主要国家和地区发展分析

一、2008年美国芯片设计行业发展分析

二、2008年日本芯片设计行业发展分析

三、2008年台湾芯片设计行业发展分析

四、2008年印度芯片设计行业发展分析

第四节 2008年世界芯片设计行业发展现状分析

一、2008年世界芯片设计行业发展规模分析

二、2008年世界芯片设计行业发展特点分析

三、2008年世界芯片设计行业竞争格局分析

第五节 2009年世界芯片设计行业发展形势分析

第六节 2008-2010年世界芯片技术发展趋势分析

一、小型化、高灵敏度

二、多功能趋势

三、芯片节能趋势

第四章 我国芯片设计行业发展现状

第一节 中国芯片设计行业现状

一、行业规模不断扩大

二、行业质量稳步提高

三、产品结构极大丰富

四、原材料与生产设备配套问题

第二节 芯片设计行业发展特点

一、产业持续快速发展

二、中国自主标准为国内设计企业带来发展机遇

三、模拟IC和电源管理芯片成为国内IC设计热门产品

第三节 2008年芯片设计行业发展分析

一、2008年芯片设计行业经济指标分析

二、2008年芯片设计业进出口贸易分析

三、2008年行业盈利能力与成长性分析

四、2008年芯片设计行业发展规模分析

五、2008年芯片设计行业发展特点分析

第四节 2008年中国芯片设计业存在的主要问题分析

一、企业规模问题分析

二、产业链问题分析

三、资金问题分析

四、人才问题分析

五、发展的建议与措施

第五章 中国芯片设计市场运行分析

第一节 2008年中国芯片设计市场发展分析

一、2008年中国芯片设计市场消费规模分析

二、2008年主要行业对芯片的需求统计分析

第二节 2008年中国芯片制造市场生产状况分析

一、2008年芯片的产量分析

二、2008年芯片的产能分析

三、2008年产品生产结构分析

第六章 芯片设计产业发展地区比较

第一节 长三角地区

一、竞争优势

二、2008年发展状况

三、2009年发展前景

第二节 珠三角地区

一、竞争优势

二、2008年发展状况

三、2009年发展前景

第三节 环渤海地区

一、竞争优势

二、2008年发展状况

三、2009年发展前景

第四节 东北地区

一、竞争优势

二、2008年发展状况

三、2009年发展前景

第五节 西部地区

一、竞争优势

二、2008年发展状况

三、2009年发展前景

第三部分 细分及关联产业发展分析

第七章 芯片设计产品细分市场分析

第一节 2008年中国芯片细分市场发展趋势分析

一、生物芯片

二、通信芯片

三、显示芯片

四、数字电视芯片

五、标签芯片

第二节 电子芯片市场

一、电子芯片市场结构

二、电子芯片市场特点

三、2008年电子芯片市场规模

四、2008年电子芯片市场分析

五、2009年电子芯片市场预测

第三节 通讯芯片市场

一、通讯芯片市场结构

二、通讯芯片市场特点

三、2008年通讯芯片市场规模

四、2008年通讯芯片市场分析

五、2009年通讯芯片市场预测

第四节 汽车芯片市场

一、汽车芯片市场结构

二、汽车芯片市场特点

三、2008年汽车芯片市场规模

四、2008年汽车芯片市场分析

五、2009年汽车芯片市场预测

第五节 手机芯片市场

一、手机芯片市场结构

二、手机芯片市场特点

三、2008年手机芯片市场规模

四、2008年手机芯片市场分析

五、2009年手机芯片市场预测

第六节 电视芯片市场

一、电视芯片市场结构

二、电视芯片市场特点

三、2008年电视芯片市场规模

四、2008年电视芯片市场分析

五、2009年电视芯片市场预测

第八章 芯片设计相关产业运营分析

第一节 通信产业运营分析

一、2008年通信行业发展分析

二、2008年通信设备产量分析

三、2008年通信市场需求分析

四、2008年通信芯片需求分析

第二节 汽车产业运营分析

一、2008年汽车行业发展分析

二、2008年我国汽车产量分析

三、2008年汽车市场需求分析

四、2008年汽车芯片需求分析

第三节 电视产业运营分析

一、2008年电视行业发展分析

二、2008年电视机的产量分析

三、2008年电视市场需求分析

四、2008年电视芯片需求分析

第四节 手机产业运营分析

- 一、2008年手机行业发展分析
- 二、2008年我国手机产量分析
- 三、2008年手机市场需求分析
- 四、2008年手机芯片需求分析

第四部分 行业竞争分析

第九章 芯片设计行业竞争现状分析

第一节 芯片设计业竞争格局分析

- 一、国际芯片设计行业的竞争状况
- 二、我国芯片设计业的国际竞争力
- 三、外资企业进入国内市场的影响
- 四、IC设计企业面临的挑战分析

第二节 我国芯片设计业的竞争现状

- 一、我国芯片设计企业间竞争状况
- 二、潜在进入者的竞争威胁
- 三、供应商与客户议价能力

第三节 2008年中国芯片设计业竞争格局分析

第四节 2008-2010年中国芯片设计竞争趋势分析

第十章 世界典型芯片设计企业发展分析

第一节 高通（QUALCOMM）

- 一、企业概况
- 二、2007-2008年财务分析
- 三、2008年经营状况
- 四、2009年发展规划

第二节 博通（BROADCOM）

- 一、企业概况
- 二、2007-2008年财务分析
- 三、2008年经营状况
- 四、2009年发展规划

第三节 NVIDIA

一、企业概况

二、2007-2008年财务分析

三、2008年经营状况

四、2009年发展规划

第四节 新帝（SANDISK）

一、企业概况

二、2007-2008年财务分析

三、2008年经营状况

四、2009年发展规划

第五节 AMD

一、企业概况

二、2007-2008年财务分析

三、2008年经营状况

四、2009年发展规划

第十一章 芯片设计行业内优势企业分析

第一节 上海华虹

一、企业概况

二、2007-2008年财务分析

三、2008年经营状况

四、2009年发展规划

第二节 中星微电子

一、企业概况

二、2007-2008年财务分析

三、2008年经营状况

四、2009年发展规划

第三节 中芯国际

一、企业概况

二、2007-2008年财务分析

三、2008年经营状况

四、2009年发展规划

第四节 大唐微电子

一、企业概况

二、2007-2008年财务分析

三、2008年经营状况

四、2009年发展规划

第五节 其他优势企业

一、士兰微电子

二、有研硅谷

三、上海蓝光

四、扬州华夏

五、深圳方大

六、大连路美

七、台湾信越

八、台湾威盛电子

第五部分 行业发展趋势及投资

第十二章 行业发展前景展望与预测

第一节 2009年发展环境展望

一、2009年宏观经济形势展望

二、2009年政策走势及其影响

三、2009年国际行业走势展望

第二节 2009年相关行业发展展望

一、2009年IC制造业展望

二、2009年IC封装测试业展望

三、2009年IC材料和设备行业展望

第三节 芯片设计行业发展趋势分析

一、技术发展趋势分析

二、产品发展趋势分析

三、行业竞争格局展望

第四节 芯片设计市场发展预测

一、2008-2010年集成电路产业增长率

二、2008-2010年中国芯片设计市场规模预测

三、2008-2010年中国芯片设计细分市场规模

四、2008-2010年中国芯片设计产业结构预测

五、2008-2010年中国芯片设计行业销售模式

第十三章 行业投资机会与风险分析

第一节 行业投资环境评价

一、2008年行业投资状况

二、在建及拟建项目分析

三、投资吸引力分析

第二节 2008-2010年行业投资机会分析

一、台湾放行四家芯片商投资大陆

二、半导体芯片产业或成投资热点

三、应用芯片研究前景广阔

四、生物芯片投资时刻到来

第三节 2008-2010年行业投资风险分析

一、市场风险

二、政策风险

三、经营风险

第四节 行业投资建议及策略

图表目录

图表：2003-2008年中国集成电路产业销售收入规模及增长

图表：2008年中国集成电路产业各产业链销售收入及增长

图表：2008年中国集成电路产业各价值链结构

图表：全球IC设计产业产值发展趋势

图表：IC设计产业成长率优于全球IC产业成长率

图表：2007年全球半导体电子设备设计国家排名

图表：全球IC设计产业布局

图表：全球IC设计产业概况

图表：2007年台湾地区前十大设计公司

图表：台湾地区历年前十大设计公司营收变化趋势

图表：2002-2008年台湾主要无晶圆厂IC设计公司营收走势

图表：2004-2010年台湾主要电源IC设计公司营收走势

图表：2001-2008年间国内生产总值增长趋势

图表：2005Q1-2008Q4年各季度国内生产总值走势

图表：2003-2008年工业增加值及增长速度

图表：2008年主要工业产品产量及其增长速度

图表：2008年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度

图表：2003-2008年固定资产投资增长情况

图表：2001-2008年中国投资率和消费率变化情况

图表：我国有线电视向数字化过渡时间表

图表：低功率芯片技术实现

图表：微笑曲线

图表：2007年中国前十大IC设计业者排名

图表：2002-2008年IC设计业销售收入

图表：2005-2008年我国芯片设计业经济指标

图表：我国IC设计业的SWOT分析

图表：西部地区一些IC设计公司

图表：2008年中国电源管理芯片市场品牌结构

图表：DLP工作原理

图表：使用DLP技术的厂商一览

图表：LCOS面板结构图

图表：2008年我国主要宏观经济指标增长的市场预测

图表：中国集成电路产业规模和增长速度

图表：2008-2012年中国集成电路产业规模预测

图表：2008-2012年中国集成电路产业链规模与增长预测

图表：2008-2011年我国IC销售额预测

图表：中国IC市场应用结构及自给能力

图表：2006-2008年华虹集团经营动态

图表：中芯国际技术文件的支持

图表：2008年全球10大半导体供应商的初步排名

图表：iSuppli按公司总部所在地对全球半导体销售额进行的初步估计

图表：软硬件协同设计流程

图表：软硬件协同设计流程

图表：设计人员正在使用电压岛、电源门控和其他功率控制技巧

图表：1999~2006年我国集成电路芯片产量变动轨迹

图表：1999~2006年集成电路及芯片产量变动轨迹

图表：2007年中国市场NVIDIA与ATI新品关注比例对比

图表：2008年中国市场最受关注的前十大显示芯片

图表：2005年中国手机基带芯片市场份额分布

图表：2008年大唐微电子技术公司主营构成

图表：2008年大唐微电子技术公司每股收益指标

图表：2008年大唐微电子技术公司获利能力指标

图表：2008年大唐微电子技术公司经营能力指标

图表：2008年大唐微电子技术公司偿债能力指标

图表：2008年大唐微电子技术公司资本构成指标

图表：2008年大唐微电子技术公司发展能力指标

图表：2008年大唐微电子技术公司现金流量指标

图表：2008年中芯国际综合损益表

图表：2008年中芯国际资产负债表

图表：2008年中芯国际现金流量表

图表：:2008年中芯国际业务构成

图表：2008年杭州士兰微电子股份有限公司主营构成

图表：2008年杭州士兰微电子股份有限公司每股收益指标

图表：2008年杭州士兰微电子股份有限公司盈利能力指标

图表：2008年杭州士兰微电子股份有限公司经营能力指标

图表：2008年杭州士兰微电子股份有限公司偿债能力指标

图表：2008年杭州士兰微电子股份有限公司资本结构指标

图表：2008年杭州士兰微电子股份有限公司发展能力指标

图表：2008年杭州士兰微电子股份有限公司现金流量指标

图表：2008年南通富士通微电子股份有限公司主营构成

图表：2008年南通富士通微电子股份有限公司每股收益指标

图表：2008年南通富士通微电子股份有限公司获利能力指标

图表：2008年南通富士通微电子股份有限公司经营能力指标

图表：2008年南通富士通微电子股份有限公司偿债能力指标

图表：2008年南通富士通微电子股份有限公司资本结构指标

图表：2008年南通富士通微电子股份有限公司发展能力指标

图表：2008年南通富士通微电子股份有限公司现金流量指标

图表：2003-2008年电信综合价格水平

图表：2003-2008年电话用户到达数和新增数

图表：2003-2008年移动电话用户所占比重

图表：2005-2008年移动电话用户各月净增比较

图表：2004年以来各月移动分组数据用户发展情况

图表：2005-2008年固定电话用户各月净增比较

图表：2003-2008年无线市话用户所占比重

图表：2003-2008年公用、办公、住宅电话用户所占比重

图表：2003-2008年网民数和互联网普及率

图表：2004年以来各月互联网拨号、宽带接入用户净增比较

图表：2003-2008年固定本地电话通话

图表：2003-2008年移动本地电话通话时长

图表：2008年长途电话通话时长

图表：2003-2008年长途电话市场构成

图表：2006-2008年IP电话发起方式

图表：2004-2008年短信业务发展情况

图表：2002-2008年我国汽车产量变化趋势图

图表：1994-2008年中国汽车行业销量

图表：2001-2008年汽车零部件行业利润变化

图表：2001-2008年整车行业库存水平变化

图表：2005-2009年汽车销量预测

图表：2001-2008年我国手机产量变化趋势图

图表：2008年手机品牌的市场份额

图表：2008年正货、水货和二手手机的市场份额

图表：2007-2008年的重点机型

图表：2008-2012年中国集成电路产业规模预测

图表：2008-2012年中国集成电路产业链规模与增长预测

图表：2008年中国芯片制造业前十大企业销售额

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200812/9238.html>